

Publikationen

- (2019): Heißprägen von Glassubstraten als Basis kapazitiver Ultraschall-Sensorik. In: 2. Technologietag Angewandte Sensorik (TAS), Coburg.
- (2019): Sensorik mit 2D-Materialien. In: Technologietag Angewandte Sensorik, Coburg.
- (2019): Precision Glass Molding of Light Emitting Optics, Containing Phosphors Directly Embossed into Glass. In: 6th Conference on Manufacturing, Tolerancing and Testing of Optical Systems, München.
- (2019): Entwicklung einer wasserdichten LED Flächenleuchte mit direkt im Glas eingebrachtem Konvertermaterial. Poster. In: DGaO Proceedings zur 120. Jahrestagung (11.-15.06.2019; Darmstadt).
- (2019): Development of a waterproof, high color fidelity LED Light Panel. In: 6th European Seminar on Precision Optics Manufacturing (POM19), Teisnach.
- (2018): Glas als Verpackungsmaterial für Lebensmittel. Posterpräsentation. In: 5. Tag der Forschung, Deggenndorf.
- (2015): Precision glass molding - practical investigation in roughness transfer mechanism between mold and preform. In: 2nd European Seminar on Precision Optics Manufacturing, Teisnach.
- (2015): Investigation in roughness transfer between mold and preform during precision glass molding. In: 4th EOS Conference on Manufacturing and Testing of Optical Components (EOSMTOC 2015), München.
- (2015): "3D-Glas". 3D-Integration von Sensoren auf Glassubstraten. In: 2. Tag der Forschung 2015, Deggenndorf.
- (2015): Electronic device and method for fabricating the same.
- (2015): Electronic Device and Method for Fabricating an Electronic Device.
- (2015): Elektronische Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Vorrichtung.
- (2015): Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements oder eines Transistorbauelements mit einer dünnen Fremdmaterialschicht in einem Halbleiterkörper.
- (2015): Electrical Contact for Graphene Part.
- (2015): Electrical Contact for Graphene Part.
- (2015): Elektrischer Kontakt für ein Graphenteil.
- (2015): Composite Wafer Having A Graphite Core.
- (2015): Semiconductor Device Having Solderable and Bondable Electrical Contact Pads.
- (2015): Halbleitervorrichtung mit lotbaren und bondbaren elektrischen Kontaktplättchen.
- (2015): Membrane structures for microelectromechanical pixel and display devices and systems, and methods for forming membrane structures and related devices.
- (2015): Membranstrukturen für mikroelektromechanische Pixel- und Anzeigevorrichtungen und -systeme sowie Verfahren zur Ausbildung von Membranstrukturen und damit zusammenhängende Vorrichtungen.
- (2015): Method for manufacturing a composite wafer having a graphite core, and composite wafer having a graphite core.

(2014): Präzisionsblankpressen, eine Verfahrensübersicht. In: 1. Tag der Forschung 2014, Deggendorf.

(2014): Method for Manufacturing a Composite Wafer Having a Graphite Core, and Composite Wafer Having a Graphite Core.

(2014): Method for manufacturing a composite wafer having a graphite core, and composite wafer having a graphite core.

(2014): Method for manufacturing a composite wafer having a graphite core, and composite wafer having a graphite core.

(2013): Manufacturing composite wafer, comprises depositing molding composition having carton powder and pitch on second side of semiconductor wafer and annealing deposited composition to form graphite.

(2013): Method for manufacturing a composite wafer having a graphite core, and composite wafer having a graphite core.

(2013): Ätzeinrichtung und Verfahren zum Ätzen eines Materials eines Werkstücks.

(2013): Procède de fabrication d'une tranche composite ayant un noyau de graphite, et tranche composite ayant un noyau de graphite.

(2013): Halbleitervorrichtung und Verfahren zur Herstellung derselben.

(2012): Method for Manufacturing a Composite Wafer Having a Graphite Core, and Composite Wafer Having a Graphite Core.

(2012): Method for Manufacturing a Composite Wafer Having a Graphite Core, and Composite Wafer Having a Graphite Core.

(2012): Ein Verfahren zum Herstellen eines Verbundwafers mit einem Graphitkern und ein Verbundwafer mit einem Graphitkern.

(2012): Composite wafer having graphite core and method for manufacturing same.

(2012): Method of etching a material surface.

(2012): Etching device and a method for etching a material of a workpiece.

(2012): Etching Device and a Method for Etching a Material of a Workpiece.

(2012): Analysis of copper oxide films by combined scanning microscopy. In: 6th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings (THINFILMS2012), Singapur, Singapur.

(2011): Verfahren zum Herstellen eines Kondensatorbauelements.

(2011): Method for producing a semiconductor including a foreign material layer.

(2010): Verfahren zur Herstellung einer Materialschicht in einem Halbleiterkörper.

(2010): Method for producing material layer in semiconductor body.

(2010): Capacitor device with a layer structure disposed in a meander-shaped manner.

(2010): Halbleitervorrichtung und Verfahren zur Herstellung derselben.

(2009): Semiconductor Device and Method for Producing the Same.

(2009): Method for Etching a Material Surface.

(2009): Method for producing a semiconductor including a material layer.



(2008): Capacitor device with a layer structure disposed in a meander-shaped.

(2008): Kondensatorbauelement mit einer mäanderförmig angeordneten Schichtstruktur.

(2008): Integrierte Halbleiterschaltungsanordnung sowie Verfahren zu deren Herstellung.

(2006): Integrierte Halbleiterschaltungsanordnung sowie Verfahren zu deren Herstellung/Semiconductor integrated circuit (IC) arrangement used in e.g. logic circuits, high-frequency (HF) amplifier circuits.

(1999): Thermoelektrischer Detektor zur Detektion von kontinuierlicher und gepulster Strahlung und Verfahren zur Herstellung/Thermoelectrical detector for detecting continuous, pulsed radiation, e.g.

(1999): Thermoelektrischer Detektor zur Detektion von kontinuierlicher und gepulster Strahlung und Verfahren zur Herstellung.